



## Tagesordnung

Thema: 70. Treffen des Arbeitskreises  
„Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und  
Verbindungstechnologien“

Datum: **28. Oktober 2020, 10.00 Uhr**

Ort: Online via MS Teams

Teilnehmer: AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
Realisierung hochminiaturisierter robuster Funksensorknoten mittels  
Komponenteneinbettung in die Leiterplatte  
*Herr Schütze, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 3 10:50 Uhr  
Messmethodik microDAC® zur Charakterisierung und  
Zuverlässigkeitsbewertung mechanisch und thermo-mechanisch beanspruchter  
mikroelektronischer Systeme für die Mobilität der Zukunft  
*Frau Seiler, Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH, Chemnitz*
- 4 11:30 Uhr  
Minuten statt Wochen - Beschleunigte Prüfung von Dickdrahtbonds  
*Herr Schmitz, Bond IQ, Berlin*
- 5 12:10 Uhr  
Mittagspause

- 6 13:10 Uhr  
Reflow-Löten mit Diodenlasern  
*Herr Rütering, Laserline, Mülheim-Kärlich*
- 7 13:50 Uhr  
Eigenspannungen im Verguss: Vorhersage und konstruktive Maßnahmen zur Reduktion  
*Herr Dr. Rütters, Fraunhofer IFAM, Bremen*
- 8 14:30 Uhr  
Kaffeepause
- 9 15:00 Uhr  
Analyse der Reaktionsprodukte von Metall-Formiaten im rückstandsfreien Lötprozess  
*Herr Elger, Technische Hochschule Ingolstadt, Ingolstadt*
- 10 15:40 Uhr  
Prozess Simulation von Fan-Out Packaging: Einfluss von Material und Geometrie auf die Verwölbung  
*Herr van Dijk, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 11 16:20 Uhr  
Abschlussdiskussion  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**